

金属、金属酸化物向 研磨スラリー (CLEALITE シリーズ)

Polishing Slurry For Metal,
Metal Oxide (CLEALITE SERIES)



この写真はイメージです。
This photograph is an image.

CLEALITEシリーズは、各種金属、サファイア、Al陽極酸化膜などの金属酸化物表面を、平滑化するために設計された研磨材です。機械加工痕や成形痕を効率よく除去し、均一な平滑面を得ることができます。

一般工業部品、装飾品、LED支持基板、サファイアカバーガラス表面の加工痕除去、平滑化、光沢、質感の向上に最適です。

1. 加工能力が高い、アルミナ砥粒を使用
2. 砥粒サイズの均一性に優れ、欠陥のない均一表面が得られる
3. 洗浄性に優れ、後工程に悪影響を及ぼしにくい

CLEALITE Series is a kind of polish material which is designed for planarization of surface of various kind of metal,sapphire,metal oxide surface like Al anodized film etc.It can effectively remove machine traces and molding marks ,can achieve even flat smooth surface.It is most suitable for removing process traces and increasing flatness,gloss and texture for general industrial parts, accessories,substrate for LED, sapphire glass cover. Ideal for removal of processing marks on the glass surface, improvement in smoothing, gloss, texture.

- 1) High processing capability since using special alumina abrasive
- 2) Able to achieve uniform surface with no specific defects due to abrasive size with excellent uniformity
- 3) Made cleaning excellent thus will not exert bad influence for the subsequent process

(研磨対象物)

CLEALITE 10,51,100 : Al,Ti,SUS 等各種合金
CLEALITE 35,37 : サファイア (c面)

(Object for polish)

CLEALITE 10,51,100 : Al,Ti,SUS etc various alloy
CLEALITE 35,37 : Sapphire (c-plane)

(製品ラインナップとその特性) (Product Line-up and features)

商品 Product		CLEALITE 10	CLEALITE 51	CLEALITE 100	CLEALITE 35	CLEALITE 37
特徴 Special Feature		高平滑 High smoothness	標準レート Standard Removal Rate	高レート High Removal Rate	高レート 高平滑 片面研磨用 High Removal Rate High smoothness For single side polisher	高レート 高平滑 両面研磨用 High Removal Rate High smoothness For double side polisher
砥粒 Abrasive	種類 Type	アルミナ Alumina	アルミナ Alumina	アルミナ Alumina	アルミナ Alumina	アルミナ Alumina
	サイズ Size	0.2-0.5μm	1-2μm	2-5μm	0.5-1.0μm	0.5-1.0μm
pH [-]		2 - 3	2 - 3	2 - 3	12.5 - 13.5	12.5 - 13.5
推奨希釈率 Dilution Rate		1 - 2	1 - 3	1 - 3	3	4
用途例 Example of application	ラフ研磨 Rough Polish		Al, SUS, Ti Ra : 20-30nm	Al, SUS, Ti Ra : 30-50nm		
	ファイン研磨 Fine Polish	○ (SUS, Al陽極酸化膜) (SUS,Anodized Layer) Ra : <10nm			サファイア (c面) Sapphire (c-plane) Ra : <0.3nm	サファイア (c面) Sapphire (c-plane) Ra : <0.3nm

(推奨パッド)

金属ラフ研磨 : ポリウレタン、不織布
金属ファイン研磨 : スウェード
サファイア (c面) : ポリウレタン、不織布

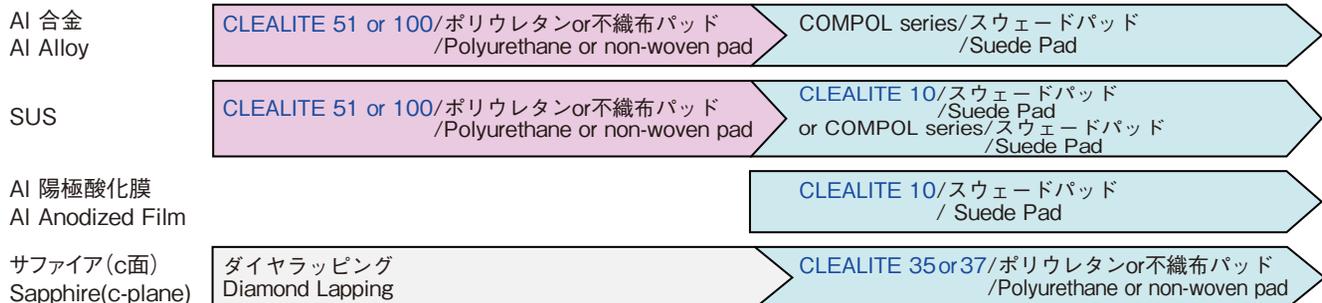
(Recommendation for polish pad)

Metal Rough Polish : Polyurethane ,non-woven
Metal Fine Polish : Suede
Sapphire (c-plane) : Polyurethane,non-woven

【研磨プロセス例】【Examples】

【ラフ研磨工程】【Rough Polish Process】

【ファイン研磨工程】【Fine Polish Process】



<本製品に関するお問い合わせ先>
株式会社フジミインコーポレーテッド 新規事業営業部
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ1-8
TEL (058) 379-3170 FAX (058) 379-3171

<Enquiry for this product>
FUJIMI INCORPORATED NEW BUSINESS SALES DEPARTMENT
〒509-0109 1-8 Techno Plaza ,Kakamigahara,Gifu,Japan
TEL (058) 379-3170 FAX (058) 379-3171



株式会社フジミインコーポレーテッド

本社 : 〒452-8502 愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1
TEL(052)855-2773

FUJIMI INCORPORATED

1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8502 Japan